

深圳顺络电子股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施 及相关主体承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）以下关于本次非公开发行 A 股股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。

公司本次拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，具体如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设、前提

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会核准并发行的实

际情况为准，具体假设如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

2、假设公司于 2020 年 11 月底完成本次非公开发行（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准）；

3、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本 80,631.84 万股为基础。除此之外，仅考虑本次非公开发行的影响，未考虑股票回购注销等其他因素导致股本及限制性股票数量变动的情形；

4、假设本次非公开发行股票募集资金总额为 148,000.00 万元，暂不考虑相关发行费用；发行股份数量为 8,249.7202 万股。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；本次非公开发行实际募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5、2018 年及 2019 年公司归属于母公司净利润分别较上年增长 40.23%与下滑 16.07%，假设公司 2020 年度归属母公司所有者的净利润与 2019 年相比分别持平、增长 10%、增长 20%（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；

6、未考虑公司 2019 年度利润分配情况的影响，未考虑预案公告日至 2020 年末可能分红的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；

7、未考虑非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；

8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

9、上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的

影响，不代表公司对 2020 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。

（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下（注：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算）：

项目	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	
		本次发行前	本次发行后
总股本	80,631.84	80,631.84	88,881.56
假设情形 1：2020 年度归属母公司所有者的净利润与上年持平			
归属于母公司股东净利润（万元）	40,169.00	40,169.00	40,169.00
基本每股收益（元/股）	0.50	0.50	0.49
加权平均净资产收益率	9.36%	8.70%	8.47%
假设情形 2：2020 年度归属母公司所有者的净利润较上期增长 10%			
归属于母公司股东净利润（万元）	40,169.00	44,185.90	44,185.90
基本每股收益（元/股）	0.50	0.55	0.54
加权平均净资产收益率	9.36%	9.53%	9.28%
假设情形 3：2020 年度归属母公司所有者的净利润较上期增长 20%			
归属于母公司股东净利润（万元）	40,169.00	48,202.80	48,202.80
基本每股收益（元/股）	0.50	0.60	0.59
加权平均净资产收益率	9.36%	10.35%	10.08%

由上表可知，本次非公开发行完成后，预计短期内公司基本每股收益、加权平均净资产收益率将可能出现一定程度的下降，因此，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下，如

果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次非公开发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会选择本次发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

新型电子元器件是电子元件“十三五”规划重点发展的产品和技术，是信息技术的三大支柱之一，受到我国政府的重点支持，它体现了当代和今后电子元器件向高频化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、响应速率快、高分辨率、高精度、高功率、多功能、组件化、复合化、模块化、智能化等的发展趋势。

1、国家战略新兴产业建设，离不开上游电子元器件行业的发展支持

党的十八届五中全会提出，要构建产业新体系，加快建设制造强国，实施《中国制造二〇二五》，实施工业强基工程，培育一批战略性新兴产业。《中国制造 2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，是应对新一轮科技革命和产业变革、加快制造业转型升级的重大战略任务和重大政策举措。国家的电子元器件生产配套能力，属于工业的基础能力，《中国制造 2025》中指出“核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。要坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则，着力破解制约重点产业发展的瓶颈”。

到 2020 年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件（元器件）和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。到 2025 年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80 种标志性先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。

2018 年以来，受中美贸易摩擦的影响，全球单边主义、贸易保护主义趋势

抬头，“中兴事件”使得中央、国务院及产业层面对核心产品、核心技术的“自主可控”能力重视程度空前，近几年来，国家大力发展的强基工程、四基工程中，基础电子材料与元器件都占据着非常显要的位置。国家“十三五”实施的制造强国战略，重点推进的新一代信息技术、新能源汽车等战略新兴产业的建设，均离不开产业链上游核心部件的技术发展支持。

2、与国外电子元器件产业发展水平相比，国内电子元器件行业仍需继续加大生产、研发投入

从我国电子元器件的发展现状看，西方领先优势相对明显。由于西方发达国家在电子元器件行业的研发起步较早、投入较大，如美国、日本等西方国家其在电子元器件行业中所投入的研发强度都已经超过 5%，部分企业的投入高达 10% 以上。因此，这些国家在电子元器件行业中处于领先地位。相较之下，我国电子元器件起步晚，发展较为缓慢，与国外的领先水平仍存在一定差距，从电子元器件产业链来说，尽管我国的片式电阻器、片式独石陶瓷电容器、压电陶瓷滤波器 etc 个别产品已达到规模经济生产要求，但部分高端器件仍以进口为主，受贸易摩擦、贸易保护主义的影响，国内进口高端器件、引进国外先进技术仍受到诸多环节、条件的制约。国内电子元器件生产企业仍需继续加大研发投入，依托庞大的电子信息工业需求端的提升作用，不断提升生产规模、提高配套能力、强化技术投入、缩短与国外先进水平的差距。

3、从世界电子元器件发展趋势来看，新型电子元器件正在向片式化、微型化、高频化、宽频化、高精度化、集成化方和绿色环保方向发展

新型电子元器件体现当代和今后电子元器件向高频化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、响应速率快、高分辨率、高精度、高功率、多功能、组件化、复合化、模块化和智能化等的发展趋势。同时，产品的安全性和绿色化也是影响其发展前途的重要因素。

从世界电子元器件的技术发展趋势来看：总体来说，片式化已经成为衡量电子元件技术发展水平的重要标志之一，其中，片式电容、片式电阻、片式电感三大无源元件，约占元器件总产量的 85%-90%。电子元器件在片式化的同时，也在向小型化方向迅速发展，随着电子设备小型化进程的加快，电子元件复合化和

集成化的步伐也在加快。由于电子元器件产品种类很多，各分类产品在技术发展趋势上又各有自身的特点。

从电子元器件科技发展新趋势看：当前，随着传统元器件科研生产逐步地走向成熟，电子元器件科技正步入以新型材料、新工艺和新技术带动下的产品更新升级和深化发展的新时期，电子元器件由原来只为适应整机的小型化及其新工艺要求为主的改进，变成以满足数字技术、微电子技术发展所提出来的特性要求为主，而且是成套满足发展阶段，呈现出多个方面的新特点。

未来 5 至 10 年，电子元器件片式化、微型化、高频化、高速化、集成化、绿色化的发展趋势将继续扩大；低温共烧陶瓷（LTCC）技术、电磁兼容技术、高精度高性能传感器技术以及绿色环保技术将成为影响电子元器件领域发展的关键技术。

4、智能制造为电子元器件发展提供发展机遇

当今社会科技的发展日新月异，产品的更新换代的时间越来越短，而这一切的进步都离不开电子元器件及新兴材料的发展。电子元器件是电子设备及信息系统的重要基础之一，其发展速度、技术水平高低和生产规模，不仅直接影响着电子信息产业的发展，而且对改造传统产业，促进科技进步，提高装备现代化水平都具有重要的现实意义。

智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。

从传统制造业发展角度看，改革开放以来，经过几代人的努力，我国建立了门类比较齐全、产能巨大的制造业体系。据联合国调查统计，我国拥有 39 个工业大类、191 个中类和 525 个小类，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，从而形成了一个举世无双、行业齐全的工业体系，号称“世界工厂”。但从我国制造业目前的总体情况看来，存在着制造业发展异常迅速，产业基础越做越大，但总体科技含量不高、中低端产能多、生产设备的品质、稳定性、扩展性与国外相比还有差距，存在缺少技术工人、自主产品有限、一线工人文化

素质不高等特点。

为加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，突破制造业重点领域关键技术实现产业化，国家发改委 2017 年 11 月再次发布了《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》，再次为新时期智能制造和推动我国向制造强国提供了强有力的政策支持。

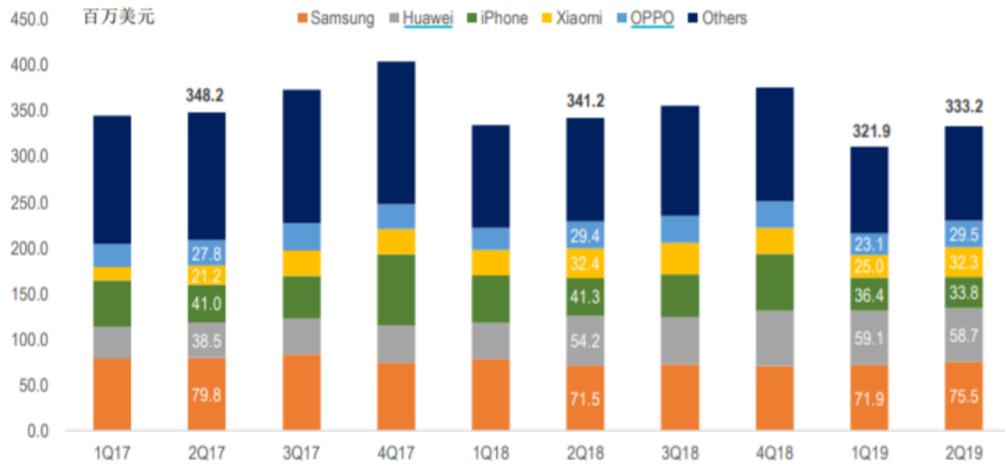
以新型电子元器件为代表的新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点；智能制造加速引领制造业整体变革，重塑产业价值链体系，推动制造业转型升级和创新发展，新一代信息技术产业由此迎来重要战略发展机遇。

5、被动元件下游市场需求继续保持扩容态势

过去十年（2009 年至 2019 年），以智能手机为代表的智能终端，市场容量提升、技术性能升级、产品迭代带动了被动元器件行业的快速发展，具体体现手机出货量快速增长及手机智能化性能提升带来单机用量的增长上，伴随下游行业技术迭代，被动元件也向高频化、轻薄（小型）化、集成化等方向发展。未来十年，驱动被动元件继续发展的增长因素除却智能手机的产品升级外，5G 通讯、汽车电子、工业 4.0 及云计算等行业深入发展，将进一步推升被动元件的需求，根据 Paumanok 的统计预测，全球被动元件市场空间将由 2017 年的 238 亿美元增长至 2020 年的 286 亿美元，年复合增速 6.3%。其中，2020 年被动元件在网络通信、车载、电力及工业领域的需求将分别达到 120 亿、46 亿及 29 亿美元，前述应用领域相较 2017 年的市场需求量分别实现 11.6%、9.4% 及 7.4% 的年复合增长率，并继续维持较快增速，在这样的行业背景下，被动元器件行业将继续迎来新一轮增长动力。

6、智能终端仍然是拉动电子元器件产业发展的主要引擎，手机的智能化、5G 通信技术的普及，智能终端整体出货量将迎来新一轮增长

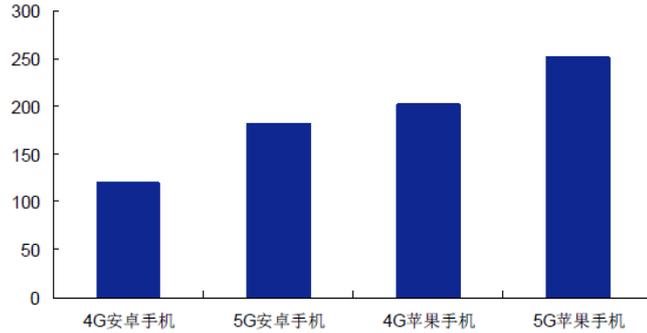
从具体的出货量来看，2017 年四季度峰值以后，全球手机出货量呈现波动下降的趋势：



但从 GfK 统计的全球智能手机市场规模来看，2013 年至 2018 年的全球智能手机的市场规模仍保持逐年增长的趋势：



尽管主流手机品牌出货量在 2018 年以来出现小幅度下降，但整体市场规模有所上升，体现手机均价有明显的增长，智能终端已经整体向中高端进行迭代，智能手机的创新和升级将带动被动元器件单机需求量提升，比如加载双摄、3D 感应、无线充电、快充技术、无线耳机、屏下指纹识别等新应用。随着产品功能的复杂化，多元化，需要更多的元器件来进行稳压、稳流、滤杂波，以保障终端设备的正常运作，更快的连接和更强大的处理能力需要更多的被动元件。



适应 5G 技术的普及以及基于 5G 的基础通信网络铺设，下一步智能手机将逐步完成 3G/4G 向 5G 技术升级，智能手机出货量将乐观增长。手机为了实现 5G 功能，譬如高速率低延迟、AR/VR、高清视频和直播，分别对存储、摄像头、屏幕分辨率及尺寸的性能提出了更高的要求，对被动元件的需求将稳步提升。

根据 IDC 预测，2023 年手机出货量将达到 15.42 亿部，其中 5G 手机的市场份额将从 2019 年的 0.50% 上升至 2023 年 23.90%，具体如下表：

单位：百万部

通信制式	2019 年出货量	市场份额	YOY	2023 年出货量预测	市场份额	YOY
3G	57.5	4.10%	-25.40%	34.6	2.20%	-3.40%
4G	1330.6	95.40%	0.20%	1105.9	71.70%	-4.40%
5G	6.7	0.50%	N/A	401.3	26%	23.90%
总计	1394.9	100%	-0.80%	1541.8	100%	1.70%

7、5G 通信时代，基站对叠层片式射频电感与功率电感需求将成倍增长

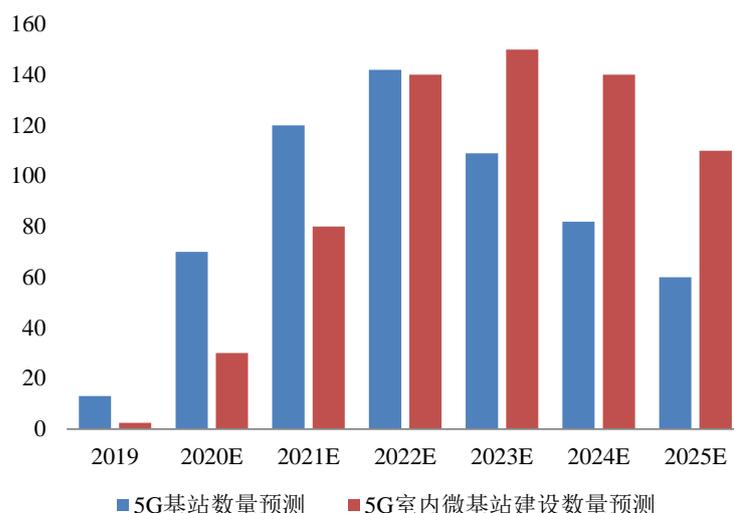
在基站建设应用上，叠层片式射频电感及功率电感的用量随着信道数量的增加而提升。基站中，叠层电感、绕线电感及铁氧体磁珠应用于射频电路。绕线电感由于其高 Q 值的特性，带通的衰减特性好，可以确保天线的首发信号灵敏度，常用于与天线匹配的电路中；叠层电感用于与射频的匹配电路，起到耦合、扼流及共振的用途。相较于 4G 基站，5G 基站信道数量由 32 信道转为 64 信道、单个基站由 1 个天线扇面增加至 3 个天线扇面，叠层片式射频电感用量提升至 6 倍，具体如下表所示：

产品	4G 基站	5G 基站	提升逻辑
叠层片式射频电感	100	600	32 信道转为 64 信道；360°布站，单个基站有 3 个天线扇面

功率电感	20	60	360°布站，单个基站有3个天线扇面，用量增加3倍
------	----	----	---------------------------

资料来源：西部证券研发中心

从整体的电感用量来看，4G基站的总电感用量为1100-1300颗，而5G基站的整体单站电感用量提升了30%以上，增加至1600-1700颗，进一步促进了电感产品的需求增长，下图列式了2020年至2025年室外5G基站及室内微基站的建设数量预测情况，预计2022年至2023年将迎来5G基站的建设高峰：



资料来源：智研咨询《2020-2026年中国移动通信基站行业市场现状调研及投资机会预测报告》

8、汽车电子应用普及、新能源汽车渗透率提升是下一轮驱动电子元器件行业发展的重要动力

汽车电子产品主要包括车载电子、车身电子、动力控制以及底盘与安全控制四大类。汽车电子主要分为汽车电子控制装备和车载电子装置两类，控制装备主要是保证汽车的行驶功能；车载电子装置主要是提升汽车的便利性和舒适性。随着汽车的不断普及，消费者越来越重视汽车的安全性能和驾驶体验，汽车制造商们也在不断尝试车载影音娱乐的各种可能性。

在汽车销量整体下滑、行业低迷的背景下，由电动化和智能化带来的结构性红利凸显，传统燃油车企业在行业竞争加剧、消费市场渗透率下降背景下不断进行产品智能化升级，形成差异化比较优势；同时，以中国为代表的后工业化国家，政策加码新能源汽车领域，实现汽车工业的整体赶超升级；同时，在特斯拉

等新消费主义车企的带领下，传统全球知名汽车品牌持续推出新能源汽车产品线，整体汽车行业出现结构化的增长趋势。



数据来源：EV Tank 联合伊维经济研究院在北京发布的《全球新能源汽车市场中长期发展展望（2025）》

在这样的背景下，汽车行业对汽车电子的需求持续提升，主要体现在车载娱乐信息系统、ADAS 自动驾驶系统以及电动控制系统将成为汽车电子的核心增长驱动，并推动市场渗透率的持续提升，预计 2030 汽车电子的渗透率将达到 50%。汽车中使用的电器和电子产品元件占汽车总成本的比例逐年增加，据统计，每辆汽车使用的电子元件来看，中端车平均用量 6,300 个，高端车 8,200 个，纯电动汽车增加到 14,000 个，预计到 2030 年车用电器与汽车电子元件成本占比将达到 50% 以上，驱动汽车电子行业快速成长。从全球汽车电子市场空间来看，将从 2015 年的 190 亿美元，增加到 2025 年的 320 亿美元，汽车电子应用普及、新能源汽车渗透率提升是下一轮驱动电子元器件行业发展的重要动力。

（二）本次非公开发行的目的

1、在下游需求产业扩容的背景之下，进一步提高核心产品产能，丰富产品系列

2020 年被动元件在网络通信、车载、电力及工业领域的需求预计分别达到 120 亿、46 亿及 29 亿美元，前述应用领域相较 2017 年的市场需求量分别实现 11.6%、9.4% 及 7.4% 的年复合增长率，并继续维持较快增速，在这样的行业背景

下，被动元器件行业将继续迎来新一轮增长动力。公司本次非公开发行，旨在下游需求产业继续扩容的背景之下，一方面提高片式电感的产能，解决目前公司产能不足问题；另外一方面，加强公司产品在通信、汽车电子等行业领域的推广应用，为公司下一步发展奠定稳固的产品、市场基础。

2、引入战略投资者，改善股东结构，提升公司综合竞争力

战略投资者可充分调动其在各领域的优质资源，发挥其在业务、资本、管理等方面的优势支持公司发展；同时，引入战略投资者是公司改善股权结构、完善治理结构的重要举措。通过本次非公开发行引入战略投资者，将有利于增强公司股东背景，促进现有业务的发展，完善公司治理结构，提高整体管理水平，进而提升公司的综合竞争力。

3、进一步明确公司控制权结构，优化治理架构

本次非公开发行完成后，袁金钰、施红阳等 22 名作为本次发行之发行对象的核心员工将与恒顺通通过一致行动关系实现对公司的共同实际控制，本次非公开发行旨在明确上市公司的控制权结构，有利于进一步优化公司治理架构，继续保持公司的稳健发展。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要从事精密高端电子元器件的研发、生产及销售。本次募集资金主要一方面用于提高公司高精密片式电感、陶瓷器件的产能，解决公司目前产能紧张问题；另外一方面加强公司产品在汽车电子、5G 通信等领域的应用，进一步丰富公司产品线与应用领域。本次募集资金投资项目符合行业发展趋势和本公司长期发展战略，有利于提升公司市场竞争力，增强公司盈利能力，为公司股东创造合理、稳定的投资回报，实现公司的长期可持续发展。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司在电子元器件行业深耕多年，培育形成了精通管理和技术且具备战略眼光的领导团队，同时培养了大批理论知识扎实、实战经验丰富的专业技术人才和生产运营团队，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

公司已经储备了较为丰富的核心技术及生产人员以满足募集资金投资项目的实施，未来随着项目的逐步建设和投产，公司将根据需要，综合采用内部培训、社会招聘等方式招聘配套岗位的人员，进一步完善人员配置，为募集资金投资项目的实施储备充足的人力资源。

2、技术储备

公司始终把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，持续加大研发投入，技术创新能力不断提升。公司已形成与高端精密电子元器件相关的核心专利矩阵，建立了科技创新管理体系，形成了科学、规范的研发流程，并培养了一支综合素质优秀、技术实力强劲、实践经验丰富的研发团队，为技术创新提供了更加坚实的后盾。通过多年的技术研发积累，公司已具备了自行完成募集资金投资项目的技术能力。

3、市场储备

公司本次实施的募集资金投资项目系公司主营业务的延伸与扩展，所面临的市场环境与公司现有业务具有高度相关性。公司多年深耕高端精密电子元器件行业，凭借良好的信誉和过硬的质量，公司在下游行业中累积了一批优良、稳定的客户资源。

综上，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，募集资金到位后，公司将按照计划推进募集资金投资项目的投资建设。

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施

为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报的能力，公司拟采取如下填补措施：

（一）加强募集资金管理

本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《募集资金管理办法》

的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各环节。

（二）完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司现行《公司章程》已经建立健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）的规定，公司董事会同时制定了相应的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，以细化《公司章程》相关利润分配的条款，确保股东对于公司利润分配政策的实施进行监督。

（三）提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，提升经营效率

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将继续着力提高内部运营管理水平，提高资金使用效率，完善投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，控制资金成本，提升资金使用效率，加强费用控制，全面有效地控制公司的经营风险。同时，公司将持续推动人才发展体系建设，优化激励机制，最大限度地激发和调动员工积极性，提升公司的运营效率、降低成本，提升公司的经营业绩。

（四）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（五）关于后续事项的承诺

公司承诺将根据中国证监会、深交所后续出台的实施细则，持续完善填补被

摊薄即期回报的各项措施。

六、公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

为确保公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束；

(3) 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深交所等证券监管机构制定的有关规定，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。

七、公司主要股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司主要股东袁金钰、恒顺通对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

(2) 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

(3) 承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深交所等证券监管机构制定的有关规定，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。

八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》已经公司于 2020 年 5 月 27 日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过，并将与本次非公开发行方案一并提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十八日